

# COBのワークによる仕様

## I ベアチップ仕様

①チップサイズ	1.0×1.0mm以上	③電極の材質	アルミ(AI) / 金(Au)
②電極サイズ・ピッチ	最小 電極50μm ピッチ60μm	④支給の状態	トレー / ウエハ

## II 基板の仕様

①サイズ	80×260mm以内
②エリア	<p>MAXサイズとした場合、下図のマトリクスでは5回搬送で色のついたエリアがボンディング可能 (搬送エリアプログラム可能、下図はMAX時)</p>
③材質	FR4 CEM3 その他については条件の検討が必要
④レイアウト及びサイズ	<p><b>a: ボンディングパット</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エッチングレートを考慮し、トップ値(図参照)が<math>0.12\text{mm} \times 0.22\text{mm}</math>以上になること。</li> <li>・IC外形より<math>0.8\text{mm}</math>以上の間隔をあけること</li> <li>・ボンディングパット末端より<math>1.0\text{mm}</math>以上を樹脂封止エリアとする</li> </ul> <p><b>b: フィディシャル(基板の認識用)マークは十字形状を基本とし、ベアチップの対角2箇所に配置すること</b></p> <p>半田ランド</p> <p><b>c: 半田ランドまでの間隔を<math>3\text{mm}</math>以上あけること(樹脂の広がり先端より)</b></p>
⑤メッキ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電解金メッキ (膜厚<math>0.3\mu\text{m}</math>以上)</li> <li>・無電解金 / フラッシュ金メッキ (膜厚<math>0.05\mu\text{m}</math>以上) プラズマクリーニングが必要</li> </ul>

その他の仕様に関しましても一度ご相談下さい。



0120 - 976 - 634



メールによるお問合せはこちらから

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00 (土日祝日を除く)

仕様に関する内容は、予告なく変更する場合があります。

Copyright © 2012, Taihoh CO., LTD. All right reserved. 著作権は株式会社大興に帰属します。